

2018-2024年中国集成电路 封装行业市场运营态势与投资决策分析报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2018-2024年中国集成电路封装行业市场运营态势与投资决策分析报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/qita/883827JOPE.html>

报告价格：印刷版：RMB 9800 电子版：RMB 9800 印刷版+电子版：RMB 10000

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

在中国集成电路产业的发展中，封装测试行业虽不像设计和芯片制造业的高速发展那样抢眼，但也一直保持着稳定增长的势头。特别是近几年来随着国内本土封装测试企业的快速成长以及国外半导体公司向国内大举转移封装测试能力，中国的集成电路封装测试行业更是充满生机。2008-2016年，我国集成电路封装测试行业销售收入呈波动性增长，2016年行业销售收入达到1564.3亿元，同比增长13.03%。

分析认为，未来先进封装市场成长依旧强劲，包含球栅阵列封装（BGA）、芯片尺寸封装（CSP，含leadframe-based）、覆晶封装，以及晶圆级封装（WLP）。这些封装形式在未来几年皆将有强劲的单位成长率，而许多的传统封装技术则将呈现停滞或较慢成长。

报告目录

第1章：中国集成电路封装行业发展背景

1.1 集成电路封装行业定义及分类

1.1.1 集成电路封装界定

- (1) 集成电路封装产业概念
- (2) 集成电路封装产业链位置
- (3) 集成电路封装作用

1.1.2 集成电路封装行业产品分类

- (1) 按功能分类
- (2) 按集成度分类
- (3) 按封装外形分类

1.1.3 集成电路封装行业特性分析

- (1) 行业周期性失灵
- (2) 行业区域性
- (3) 行业季节性

1.2 集成电路封装行业政策环境分析

1.2.1 行业管理体制

1.2.2 行业相关政策

1.3 集成电路封装行业经济环境分析

1.3.1 国际宏观经济环境及影响分析

- (1) 国际宏观经济现状

(2) 国际宏观经济展望

(3) 国际宏观经济环境对行业影响分析

1.3.2 国内宏观经济环境及影响分析

(1) 中国GDP及增长情况分析

(2) 中国工业经济增长分析

(3) GDP与集成电路封装行业的关联性分析

(4) 居民收入水平

1.3.3 居民收入与行业的相关性

1.4 集成电路封装行业技术环境分析

1.4.1 集成电路封装技术演进分析

1.4.2 集成电路封装形式应用领域

1.4.3 集成电路封装工艺流程分析

1.4.4 集成电路封装行业新技术动态

第2章：中国集成电路产业发展分析

2.1 集成电路产业发展状况

2.1.1 集成电路产业简介

2.1.2 集成电路产业发展现状

2.1.3 集成电路产业运营情况

2.1.4 集成电路产业三大区域分析

(1) 集成电路产业分布特征

(2) 集成电路产业布局发展趋势

(3) 未来集成电路产业空间布局

2.1.5 集成电路产业面临挑战、发展途径以及发展前景

(1) 集成电路产业当下存在问题

(2) 集成电路产业“十三五”面临挑战

(3) 集成电路产业“十三五”发展途径

(4) 集成电路产业发展前景

2.1.6 集成电路产业发展预测

(1) 战略性新兴产业将加速发展

(2) 资本市场将为企业融资提供更多机会

2.2 集成电路设计业发展状况

2.2.1 集成电路设计业发展概况

2.2.2 集成电路设计业行业发展现状

- (1) 产业规模持续扩大
- (2) 产业结构调整加速
- (3) 企业规模加速发展
- (4) 技术能力大幅提升

2.2.3 集成电路设计业行业政策分析

2.2.4 集成电路设计业发展策略分析

2.2.5 集成电路设计业“十三五”发展预测

- (1) 产业规模
- (2) 企业建设
- (3) 技术水平

2.3 集成电路制造业发展状况

2.3.1 集成电路制造业发展现状分析

- (1) 集成电路制造业发展总体概况
- (2) 集成电路制造业发展主要特点

2.3.2 集成电路制造行业规模及财务指标分析

- (1) 集成电路制造行业规模分析
- (2) 集成电路制造行业盈利能力分析
- (3) 集成电路制造行业运营能力分析
- (4) 集成电路制造行业偿债能力分析
- (5) 集成电路制造行业发展能力分析

2.3.3 集成电路制造行业供需平衡分析

- (1) 集成电路制造行业供给情况分析
- (2) 集成电路制造行业需求情况分析
- (3) 全国集成电路制造行业产销率分析

2.3.4 集成电路制造业“十三五”发展预测

第3章：中国集成电路封装行业发展分析

3.1 中国集成电路封装行业发展历程

3.2 中国集成电路封装行业发展现状

3.2.1 集成电路封装行业规模分析

- 3.2.2 集成电路封装行业发展现状分析
- 3.2.3 集成电路封装行业利润水平分析
- 3.2.4 大陆厂商与业内领先厂商的技术比较
- 3.2.5 集成电路封装行业影响因素分析
 - (1) 有利因素
 - (2) 不利因素
- 3.2.6 集成电路封装行业发展趋势及前景预测
 - (1) 发展趋势分析
 - (2) 前景预测
- 3.3 半导体封测发展情况分析
 - 3.3.1 半导体行业发展概况
 - 3.3.2 半导体行业景气预测
 - 3.3.3 半导体封装发展分析
 - (1) 封装环节产值逐年成长
 - (2) 封装环节外包是未来发展趋势
- 3.4 集成电路封装类专利分析
 - 3.4.1 专利分析样本构成
 - (1) 数据库选择
 - (2) 检索方式
 - 3.4.2 专利发展情况分析
 - (1) 专利申请数量趋势
 - (2) 专利公开数量趋势
 - (3) 技术分类趋势分布
 - (4) 主要权利人分布情况
- 3.5 集成电路封装过程部分技术问题探讨
 - 3.5.1 集成电路封装开裂产生原因分析及对策
 - (1) 封装开裂的影响因素分析
 - (2) 管控影响开裂的因素的方法分析
 - 3.5.2 集成电路封装芯片弹坑问题产生原因分析及对策
 - (1) 产生芯片弹坑问题的因素分析
 - (2) 预防芯片弹坑问题产生的方法

第4章：中国集成电路封装市场产品及需求分析

4.1 集成电路封装行业主要产品分析

4.1.1 BGA产品市场分析

- (1) BGA封装技术
- (2) BGA产品主要应用领域
- (3) BGA产品需求拉动因素
- (4) BGA产品市场应用现状分析
- (5) BGA产品市场前景展望

4.1.2 SIP产品市场分析

- (1) SIP封装技术
- (2) SIP产品主要应用领域
- (3) SIP产品需求拉动因素
- (4) SIP产品市场应用现状分析
- (5) SIP产品市场前景展望

4.1.3 SOP产品市场分析

- (1) SOP封装技术
- (2) SOP产品主要应用领域
- (3) SOP产品市场发展现状
- (4) SOP产品市场前景展望

4.1.4 QFP产品市场分析

- (1) QFP封装技术
- (2) QFP产品主要应用领域
- (3) QFP产品市场发展现状
- (4) QFP产品市场前景展望

4.1.5 QFN产品市场分析

- (1) QFN封装技术
- (2) QFN产品主要应用领域
- (3) QFN产品市场发展现状
- (4) QFN产品市场前景展望

4.1.6 MCM产品市场分析

- (1) MCM封装技术水平概况
- (2) MCM产品主要应用领域

- (3) MCM产品需求拉动因素
- (4) MCM产品市场发展现状
- (5) MCM产品市场前景展望

4.1.7 CSP产品市场分析

- (1) CSP封装技术水平概况
- (2) CSP产品主要应用领域
- (3) CSP产品市场发展现状
- (4) CSP产品市场前景展望

4.1.8 其他产品市场分析

- (1) 晶圆级封装市场分析
- (2) 覆晶/倒封装市场分析
- (3) 3D封装市场分析

4.2 集成电路封装行业市场需求分析

4.2.1 计算机领域对行业的需求分析

- (1) 计算机市场发展现状
- (2) 集成电路在计算机领域的应用
- (3) 计算机领域对行业需求的拉动

4.2.2 消费电子领域对行业的需求分析

- (1) 消费电子市场发展现状
- (2) 消费电子领域对行业需求的拉动

4.2.3 通信设备领域对行业的需求分析

- (1) 通信设备市场发展现状
- (2) 集成电路在通信设备领域的应用
- (3) 通信设备领域对行业需求的拉动

4.2.4 工控设备领域对行业的需求分析

- (1) 工控设备市场发展现状
- (2) 集成电路在工控设备领域的应用
- (3) 工控设备领域对行业需求的拉动

4.2.5 汽车电子领域对行业的需求分析

- (1) 汽车电子市场发展现状
- (2) 集成电路在汽车电子领域的应用
- (3) 汽车电子领域对行业需求的拉动

4.2.6 医疗电子领域对行业的需求分析

- (1) 医疗器械制造业发展情况
- (2) 集成电路在医疗电子领域的应用
- (3) 医疗电子领域应用前景分析

第5章：集成电路封装行业市场竞争分析

5.1 集成电路封装行业国际竞争格局分析

5.1.1 国际集成电路封装市场总体发展状况

5.1.2 国际集成电路封装市场竞争状况分析

5.1.3 国际集成电路封装市场发展趋势分析

- (1) 封装技术的高密度、高速和高频率以及低成本
- (2) 主板材料的变化趋势

5.1.4 国际集成电路封装行业扶持措施借鉴

5.2 跨国企业在华市场竞争力分析

5.2.1 台湾日月光集团竞争力分析

- (1) 企业发展简介
- (2) 企业组织架构
- (3) 企业运营情况分析
- (4) 企业财务情况分析
- (5) 企业主营产品及应用领域
- (6) 企业市场区域及行业地位分析
- (7) 企业在中国市场投资布局情况
- (8) 企业最新动态

5.2.2 美国安靠（Amkor）公司竞争力分析

- (1) 企业发展简介
- (2) 企业主营产品及应用领域
- (3) 企业市场区域及行业地位分析
- (4) 企业在中国市场投资布局情况

5.2.3 台湾矽品公司竞争力分析

- (1) 企业发展简介
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业主营产品及应用领域

(4) 企业市场区域及行业地位分析

(5) 企业在中国市场投资布局情况

5.2.4 新加坡STATS-ChipPAC公司竞争力分析

(1) 企业发展简介

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业主营产品及应用领域

(4) 企业市场区域及行业地位分析

(5) 企业在中国市场投资布局情况

5.2.5 力成科技股份有限公司竞争力分析

(1) 企业发展简介

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业主营产品及应用领域

(4) 企业市场区域及行业地位分析

(5) 企业在中国市场投资布局情况

5.2.6 飞思卡尔公司竞争力分析

(1) 企业发展简介

(2) 企业主营产品及应用领域

(3) 企业市场区域及行业地位分析

(4) 企业在中国市场投资布局情况

5.2.7 英飞凌科技公司竞争力分析

(1) 企业发展简介

(2) 企业主营产品及应用领域

(3) 企业市场区域及行业地位分析

(4) 企业在中国市场投资布局情况

5.3 集成电路封装行业国内竞争格局分析

5.3.1 国内集成电路封装行业竞争格局分析

5.3.2 中国集成电路封装行业国际竞争力分析

5.4 集成电路封装行业竞争结构波特五力模型分析

5.4.1 现有竞争者之间的竞争

5.4.2 上游议价能力分析

5.4.3 下游议价能力分析

5.4.4 行业潜在进入者分析

5.4.5 替代品风险分析

5.4.6 行业竞争五力模型总结

第6章：中国集成电路封装行业主要企业经营分析

6.1 集成电路封装企业发展总体状况分析

6.1.1 集成电路封装行业制造商销售收入排名

6.1.2 集成电路封装行业制造商利润总额排名

6.2 集成电路封装行业领先企业个案分析

6.2.1 飞思卡尔半导体（中国）有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业技术水平分析

（5）企业核心竞争力分析

（6）企业发展优劣势分析

（7）企业最新发展动向

6.2.2 三星电子（苏州）半导体有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

6.2.3 上海华岭集成电路技术股份有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业运营业务情况分析

（4）企业技术及资质发展情况

（5）企业产品结构分析

（6）企业优劣势分析

（7）企业最新发展动态分析

6.2.4 山东齐芯微系统科技股份有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

(2) 企业股权结构分析

(3) 企业经营状况分析

(4) 企业产品结构分析

(5) 企业优劣势分析

(6) 企业最新发展动态分析

6.2.5 江苏钜芯集成电路技术股份有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业股权结构分析

(3) 企业发展商业模式分析

(4) 企业发展面临风险情况分析

(5) 企业经营状况分析

(6) 企业产品结构分析

(7) 企业优劣势分析

(8) 企业最新发展动态分析

6.2.6 南通华隆微电子股份有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业股权结构情况

(3) 企业商业模式分析

(4) 企业发展面临风险情况分析

(5) 企业经营状况分析

(6) 企业产品结构分析

(7) 企业优劣势分析

6.2.7 日月光封装测试（上海）有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业技术水平分析

(5) 企业销售渠道分析

(6) 企业发展优劣势分析

6.2.8 江苏长电科技股份有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业技术水平分析
- (7) 企业核心竞争力分析
- (8) 企业发展优劣势分析
- (9) 企业最新发展动向

6.2.9 苏州晶方半导体科技股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析
- (7) 企业技术水平分析
- (8) 企业核心竞争力分析
- (9) 企业发展优劣势分析

6.2.10 天水华天科技股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析
- (7) 企业技术水平分析
- (8) 企业核心竞争力分析
- (9) 企业发展优劣势分析

6.2.11 南通富士通微电子股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析

- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析
- (7) 企业技术水平分析
- (8) 企业核心竞争力分析
- (9) 企业发展优劣势分析
- (10) 企业最新发展动向

6.2.12 深圳赛意法微电子有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业目标市场分析
- (4) 企业技术水平分析
- (5) 企业发展优劣势分析

6.2.13 上海松下半导体有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业技术水平分析
- (4) 企业销售渠道分析
- (5) 企业发展优劣势分析

6.2.14 英特尔产品（成都）有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业发展优劣势分析

6.2.15 星科金朋（上海）有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业目标市场分析
- (4) 企业技术水平分析
- (5) 企业发展优劣势分析

6.2.16 英飞凌科技（无锡）有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业目标市场分析

(4) 企业技术水平分析

(5) 企业发展优劣势分析

6.2.17 苏州固锝电子股份有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业盈利能力分析

(4) 企业运营能力分析

(5) 企业偿债能力分析

(6) 企业发展能力分析

(7) 企业组织架构分析

(8) 企业产品结构及新产品动向

(9) 企业销售渠道与网络

(10) 企业经营状况优劣势分析

6.2.18 威讯联合半导体（北京）有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构及新产品动向

(4) 企业销售渠道与网络

(5) 企业经营状况优劣势分析

6.2.19 瑞萨半导体（北京）有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构及新产品动向

(4) 企业销售渠道与网络

(5) 企业经营状况优劣势分析

6.2.20 颀中科技（苏州）有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业组织架构分析

(4) 企业产品结构及新产品动向

(5) 企业销售渠道与网络

(6) 企业经营状况优劣势分析

6.2.21 安靠封装测试（上海）有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构及新产品动向
- (4) 企业销售渠道与网络
- (5) 企业经营状况优劣势分析

6.2.22 矽品科技（苏州）有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构及新产品动向
- (4) 企业销售渠道与网络
- (5) 企业经营状况优劣势分析

6.2.23 晟碟半导体（上海）有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构及新产品动向
- (4) 企业销售渠道与网络
- (5) 企业经营状况优劣势分析

6.2.24 新义半导体（苏州）有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构及新产品动向
- (4) 企业销售渠道与网络
- (5) 企业经营状况优劣势分析

6.2.25 华润微电子有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业组织架构分析
- (3) 企业经营情况分析
- (4) 企业产品结构及新产品动向
- (5) 企业销售渠道与网络
- (6) 企业经营状况优劣势分析
- (7) 企业最新发展动向分析

6.2.26 智瑞达科技（苏州）有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构及新产品动向
- (4) 企业销售渠道与网络
- (5) 企业经营状况优劣势分析

6.2.27 大唐微电子技术有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构及新产品动向
- (4) 企业销售渠道与网络
- (5) 企业经营状况优劣势分析
- (6) 企业最新发展动向分析

6.2.28 凤凰半导体通信（苏州）有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构及新产品动向
- (4) 企业销售渠道与网络
- (5) 企业经营状况优劣势分析

第7章：中国集成电路封装行业投资分析及建议

7.1 集成电路封装行业投资特性分析

7.1.1 集成电路封装行业进入壁垒

- (1) 技术壁垒
- (2) 渠道壁垒
- (3) 人才壁垒
- (4) 市场规模壁垒
- (5) 出口资质壁垒

7.1.2 集成电路封装行业盈利模式

7.1.3 集成电路封装行业盈利因素

7.2 集成电路封装行业投资兼并与重组分析

7.2.1 集成电路封装行业投资兼并与重组整合概况

7.2.2 国际集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析

7.2.3 国内集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析

(1) 通富微电公司投资兼并与重组分析

(2) 华天科技公司投资兼并与重组分析

(3) 长电科技公司投资兼并与重组分析

7.2.4 集成电路封装行业投资兼并与重组整合趋势分析

7.3 集成电路封装行业投融资分析

7.3.1 产业基金对集成电路产业的扶持分析

(1) 基金对集成电路产业的扶持情况

(2) 电子发展基金对集成电路产业的扶持建议

(3) 大基金对集成电路产业的投资情况

(4) 大基金对集成电路产业的投资建议

7.3.2 集成电路封装行业融资成本分析

7.3.3 半导体行业资本支出分析

7.4 集成电路封装行业投资建议

7.4.1 集成电路封装行业投资机会分析

7.4.2 集成电路封装行业投资风险分析

7.4.3 集成电路封装行业投资建议

(1) 投资区域建议

(2) 投资产品建议

(3) 技术升级建议

图表目录

图表1：封装在集成电路制造产业链中位置

图表2：集成电路封装行业产品分类

图表3：集成电路封装行业产品分类

图表4：集成电路封装产品按封装外形分类

图表5：我国集成电路封装企业地区分布（单位：%）

图表6：2015-2016年江苏长电科技股份有限公司销售收入季度分布（单位：万元）

图表7：集成电路封装行业主要政策分析

图表8：2011-2016年美国GDP（不变价）同比变化情况（单位：%）

图表9：2011-2016年德国GDP（现价）非季调同比变化情况（单位：%）

图表10：2011-2016年日本GDP（现价）同比变化情况（单位：%）

图表11：2015-2017年全球主要经济体经济增速及预测分析（单位：%）

图表12：2009-2016年中国国内生产总值及其增长率（单位：万亿元，%）

图表13：2015-2016年各月累计主营业务收入与利润总额同比增速（单位：%）

图表14：2016年分经济类型主营业务收入与利润总额同比增速（单位：%）

图表15：2010-2016年中国GDP增速与集成电路封装行业产值增速对比图（单位：%）

图表16：2010-2016年中国农村居民人均纯收入及增长趋势图（单位：元，%）

图表17：2009-2016年中国城镇居民人均可支配收入及增长趋势图（单位：元，%）

图表18：集成电路封装技术发展历程

图表19：集成电路封装技术示意图

图表20：集成电路封装技术应用领域

图表21：集成电路封装工艺流程

图表22：集成电路产业链示意图

图表23：集成电路业务模式示意图

图表24：2016年我国集成电路产业产值结构图（单位：%）

图表25：2009-2016年我国集成电路行业销售额增长情况（单位：亿元，%）

图表26：2008-2016年我国集成电路行业出口额情况分析（单位：亿元）

图表27：集成电路封装行业产业区域特征分析

图表28：集成电路封装行业产业区域特征分析

图表29：未来集成电路产业的整体空间布局特点分析

图表30：集成电路产业政策分析

图表31：2009-2016年我国集成电路设计市场销售额走势（单位：亿元，%）

图表32：2009-2016年中国IC企业在全全球前50的企业数量（单位：家）

图表33：2016年集成电路设计业十大企业排名（单位：亿元）

图表34：2000年以来集成电路行业政策分析

图表35：集成电路设计业新发展策略

图表36：集成电路制造业发展主要特点分析

图表37：2012-2016年国内集成电路制造行业规模分析（单位：家，亿元，%）

图表38：2012-2016年国内集成电路制造行业盈利能力分析（单位：%）

图表39：2012-2016年国内集成电路制造行业运营能力分析（单位：次）

图表40：2012-2016年国内集成电路制造行业偿债能力分析（单位：% ，倍）

图表41：2012-2016年中国集成电路制造行业发展能力分析（单位：%）

图表42：2010-2016年国内集成电路制造行业工业总产值及增长率走势（单位：亿元，%）

图表43：2010-2016年国内集成电路制造行业产成品余额及增长率走势图（单位：亿元，%）

图表44：2009-2016年国内集成电路制造行业销售产值及增长率变化情况（单位：亿元，%）

图表45：2009-2016年国内集成电路制造行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%）

图表46：2006-2016年国内集成电路制造行业产销率情况（单位：%）

图表47：2009-2016年中国封装测试行业销售收入及增长情况（单位：亿元，%）

图表48：国内封测厂商与行业前五封测厂商主要技术对比

图表49：2010-2016年全球半导体市场规模及增速（单位：亿美元，%）

图表50：半导体行业景气预测模型

图表51：2013-2015年智能手机出货量情况（单位：亿部，%）

图表52：2016年中国品牌厂商智能手机出货量前十（单位：百万台）

图表53：2011-2016年全球平板电脑市场出货量（单位：百万台）

图表54：2009-2016年集成电路生产环节产值占比走势图（单位：%）

图表55：2008-2016年中国集成电路封装行业相关专利申请数量变化表（单位：个）

图表56：2013-2017年中国集成电路封装行业相关专利公开数量变化表（单位：个）

图表57：截止到2016年中国集成电路封装行业专利技术按小组统计前十分布情况（单位：个）

图表58：截止到2016年中国集成电路封装行业专利技术前十占比情况（单位：%）

图表59：截止到2017年3月份专利数量排名前十集成电路封装行业技术说明

图表60：截止到2017年3月我国集成电路封装行业专利申请人排名前十情况（单位：个，%）

图表61：树脂粘度变化曲线图

图表62：后固化时间与抗弯强度关系曲线图（单位：h，Mpo）

图表63：切筋凸模的一般设计方法

图表64：管控影响开裂的因素的方法分析

图表65：BGA封装技术特点分析

图表66：BGA封装技术分类

图表67：PBGA（塑料焊球阵列）封装

图表68：CMMB应用市场结构（单位：%）

图表69：CMMB芯片产业链示意图

图表70：SIP产品应用领域分析

图表71：SOP封装产品

图表72：SOP封装技术特点分析

图表73：QFN生产工艺流程图

图表74：MCM封装分类

图表75：MCM封装产品需求拉动因素分析

图表76：CSP封装产品特点分析

图表77：CSP封装分类

图表78：几种类型CSP结构组成图

图表79：晶圆级封装（WLP）简介

图表80：晶圆级封装主要特点

图表81：3D封装方法分析

图表82：3D封装方法分析

图表83：2013-2016年中国电子计算机制造业主要经济指标（单位：家，万元）

图表84：2014-2017年全球IT支出（单位：十亿美元，%）

图表85：2011-2015年我国电子信息产业规模及增速（单位：亿元，%）

图表86：2011-2016年我国通信设备制造行业收入与产值规模（单位：亿元，%）

图表87：2011-2016年我国通信设备制造行业销售利润与利润总额（单位：亿元，%）

图表88：2008-2015年全球汽车电子市场规模（单位：亿美元）

图表89：全球汽车电子市场分类构成（单位：%）

图表90：2011-2016年我国医疗器械制造行业收入与产值规模（单位：亿元，%）

图表91：2011-2016年我国医疗器械制造行业销售利润与利润总额（单位：亿元，%）

图表92：集成电路封装技术在医疗电子领域应用分析

图表93：2002年以来全球各封装技术产品产量构成表（单位：亿块，%）

图表94：2013-2015年全球前十大封装测试企业亚太地区排名（单位：亿美元，%）

图表95：各种电子产品的介电常数

图表96：DNP将部件内置底板“薄型化

图表97：“MEGTRON4”的电气特性和耐热性

图表98：国际集成电路扶持措施借鉴

图表99：台湾日月光集团基本信息表

图表100：台湾日月光集团组织架构

图表101：2013-2016年台湾日月光集团经营情况分析（单位：百万新台币）

图表102：2013-2016年台湾矽品经营情况分析（单位：百万台币）

图表103：中国集成电路封装测试行业企业类别

- 图表104：集成电路封装行业上游议价能力分析
- 图表105：集成电路封装行业下游议价能力分析
- 图表106：集成电路封装行业潜在进入者威胁分析
- 图表107：集成电路封装行业替代品威胁分析
- 图表108：中国集成电路封装行业竞争强度总结
- 图表109：2015年中国集成电路封装行业制造商销售收入排名前十位（单位：万元）
- 图表110：2015年中国集成电路封装行业制造商利润总额排名前十位（单位：万元）
- 图表111：飞思卡尔半导体（中国）有限公司发展简况表
- 图表112：2012-2016年飞思卡尔半导体经营情况（单位：百万美元，%）
- 图表113：飞思卡尔半导体（中国）有限公司产品结构表
- 图表114：2012-2016年飞思卡尔研发投入情况（单位：百万美元，%）
- 图表115：飞思卡尔半导体（中国）有限公司发展优劣势表
- 图表116：三星电子（苏州）半导体有限公司基本信息表
- 图表117：2013-2015年三星电子（苏州）半导体有限公司经营情况分析（单位：万元）
- 图表118：2011-2015年三星电子（苏州）半导体有限公司销售收入变化趋势（单位：万元，%）
- ）
- 图表119：2011-2015年三星电子（苏州）半导体有限公司利润总额变化趋势（单位：万元，%）
- ）
- 图表120：三星电子（苏州）半导体有限公司优劣势分析

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/qita/883827JOPE.html>